

上海睿测微智能科技

致力于设计和生产芯片智能测试设备，我们的高低温测试系统提供灵活可扩展的智能测试平台，用于评估芯片在极端温度下的性能和可靠性。系统具备智能监测功能，确保测试精度高，数据准确稳定，是国际同类行业的领先者。



行业背景与测试挑战

当前半导体温度冲击行业面临的三温测试挑战：

信号干扰问题

高速器件信号在高低温测试中易受冷板和循环液的电磁干扰和环境影响，导致测试数据失真

温域覆盖要求

芯片功能测试需覆盖从服务器机房到智能终端等全场景应用温度范围

可靠性风险

极端温湿条件下易导致信号损失、器件性能衰减和可靠性严重降低



产品概述



智能化

智能监测芯片电气连接性、温度和湿度。测试结果清晰可靠，bug可追溯。



高速信号完整性——核心创新

大地 + 金属壳体共接地」技术解决传统三温设备流动冷媒和悬空冷板在高速信号测试中的天线效应，造成的干扰、回路不闭合、信号畸变问题。



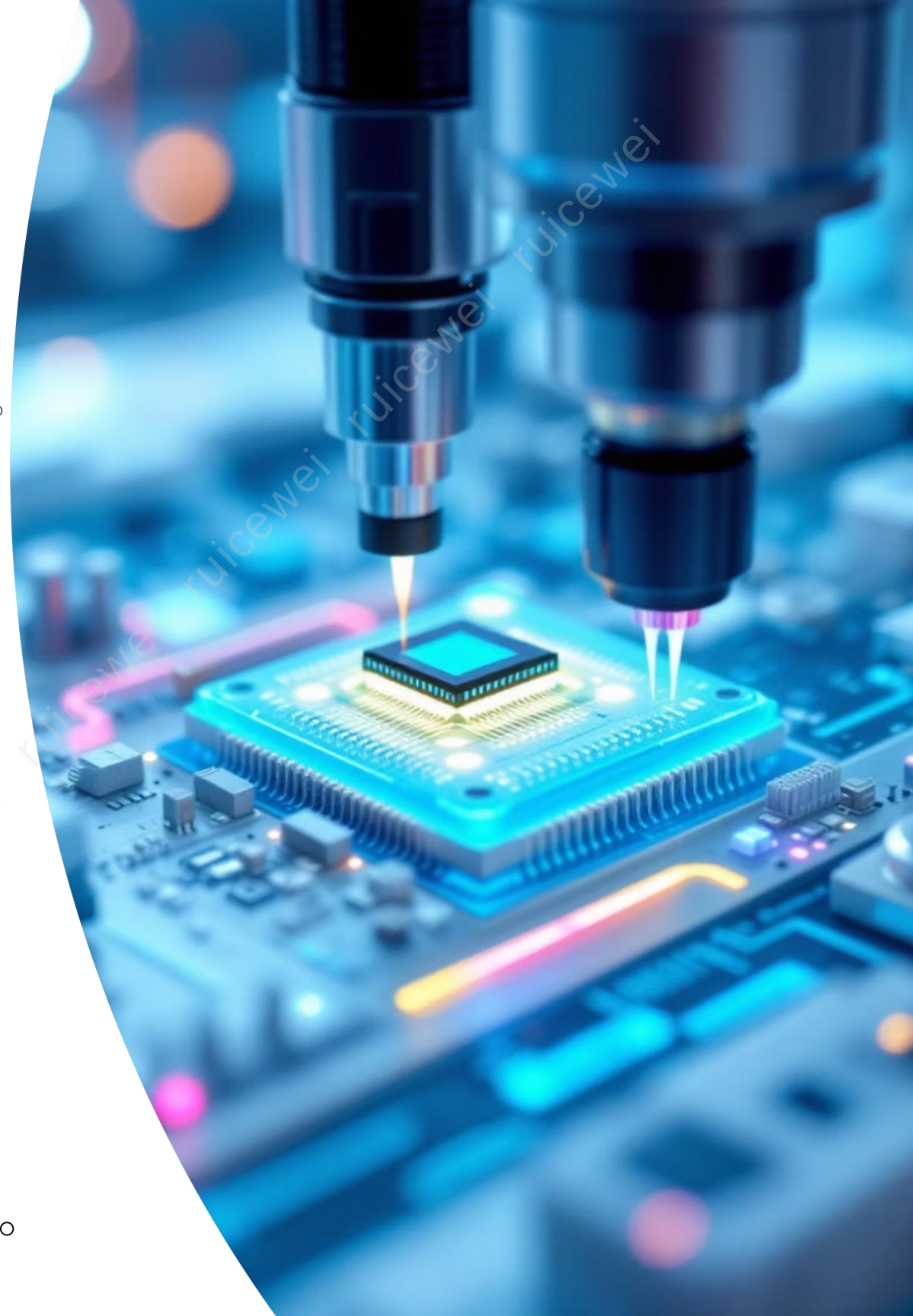
快速高效

提供可扩展的测试功能，加快测试速度和测试范围。

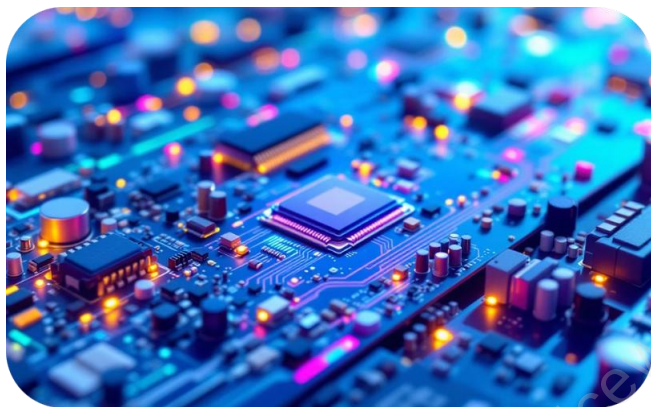


精准性

测试监测精度高，测试数据准确，稳定性高，是国际同类行业中的佼佼者。



应用领域



电子

应用于电子通信、计算机、通信设备等领域，测试芯片在不同场景下的性能表现。



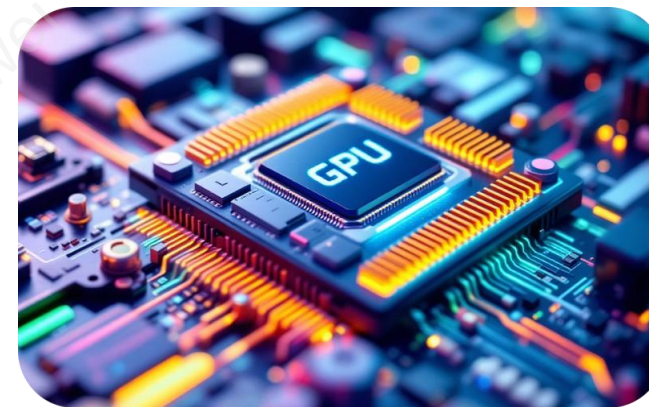
航天航空与国防

应用于卫星、导弹、飞机等领域，测试芯片在极端环境下的可靠性。



汽车工业

应用于汽车芯片测试，测试芯片在极端低温和高温环境下的自适应性和可靠性。



GPU、APU、HPC

图像处理（GPU）、加速处理单元（APU）、高性能计算（HPC）。

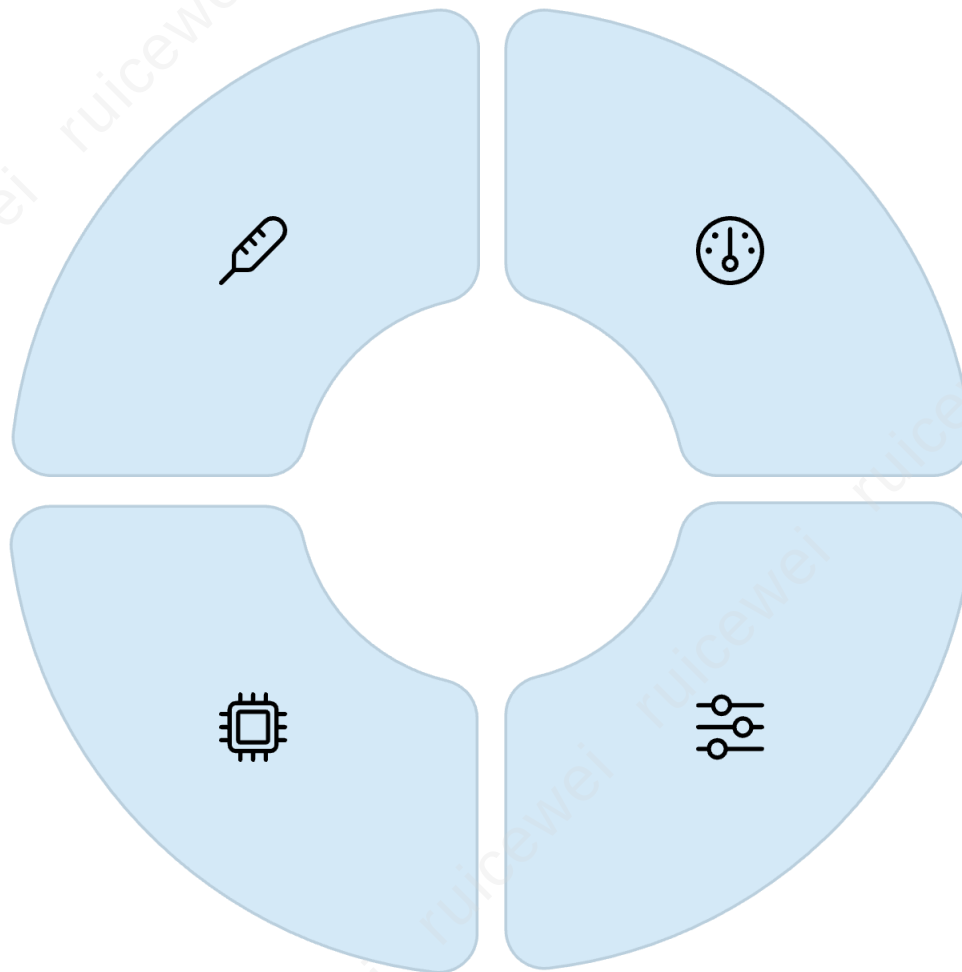
睿测微核心技术集成亮点

高低温测试

我们的系统可以在广泛的温度范围内对芯片进行测试，从极寒到高温环境都能保证测试的准确性。

智能温控系统

实现-80°C至+230°C全温域精准稳定控制，温度波动控制在 $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$ 以内
采用多区温控算法，确保温度分布均匀性



高度精密测试架

- 芯片按压：高精度传感器监测
- 智能监测：压力和温度健康监测

电磁兼容屏蔽

多层金属屏蔽结构，屏蔽效率达-60dB以上
有效隔绝外部干扰，保障测试数据纯净可靠

STD-02核心功能与技术参数



-70°C

最低温度

支持极低温环境模拟测试

230°C

最高温度

满足高温环境下芯片性能验证

0.05°C

控制精度

超高精度温控，确保测试可靠性

联系方式与技术支持



1 定制开发服务

根据客户特定需求提供个性化测试解决方案，覆盖从设计到实施的全流程支持

2 全周期维护

提供设备安装、调试、培训及定期保养服务，确保系统长期稳定运行

3 24小时技术支持

专业技术团队全天候在线，随时解答技术问题与紧急故障处理

预约产品演示或技术咨询，请联系ST解决方案团队 **15000233393**
微信同号



睿测微，芯片测试的可靠伙伴

提供-80-600℃极端温度测试，0.01℃控制精度，多通道同时测试，智能监测与分析。

关注我们，了解更多芯片测试解决方案！